

HEADERS & RECEPTACLES

SELF-SOLDERING CONNECTORS

März 2006

Steckverbinder mit Lot-Flussmitteldepots *Solder and flux bearing connectors*

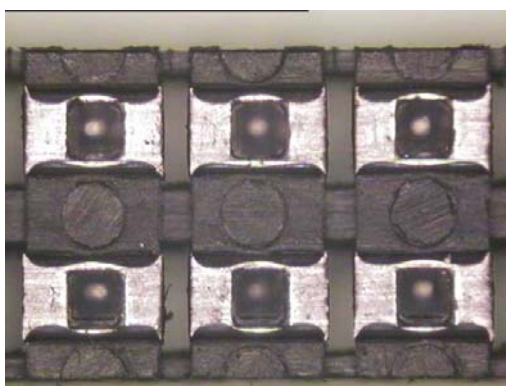
Interplex NAS Electronics GmbH bietet Steckverbinder mit Lot-Flussmittel-Depot in Durchsteck- und Einlöttechnik in verschiedenen



Stiftleiste mit Lot-Flussmitteldepots
Header with solder-flux preforms

nen Kontaktabstandsmaßen und Ausführungen an. Durch die patentierte Technik ist eine genau vorherbestimmte Menge bleifreies Lot und Flussmittel direkt an der Lötstelle vorhanden. Dadurch entfallen Arbeitsschritte wie das Auftragen von Lotpaste, das Vorverzinnen, der Auftrag von Flussmittel, und jegliche Nacharbeit. Durch die exakte Lot-

menge werden die Steckverbinder prozesssicher Reflow oder selektiv gelötet.



Stiftleiste mit Lot-Flussmitteldepots
Header with solder-flux preforms

Interplex NAS Electronics GmbH offers stack-through hole and solder pin connectors with solder and flux bearings in several pitches.

On each leadframe contact head position is a preform containing exactly the right amount of solder alloy and flux for any application. Wick-

ing and bridging are eliminated and expensive rework is a thing of the past.

- ◆ **HC Serie** Stiftleisten– .100“ [2,54mm]
vertikale und reverse Anwendung
HC series headers
vertical and revers application
- ◆ **HR Serie** 90° Stiftleisten– .100“ [2,54mm]
HR series right angle header
- ◆ **HM Serie** Stiftleisten– .787“ [2,00mm]
vertikale und reverse Anwendung
HM series headers
vertical and revers application
- ◆ **2MR Serie** Buchsenleisten, niedrige Ausführung– .787“ [2,00mm]
2MR series low profil receptacle
- ◆ **2MR Serie** Buchsenleisten, Durchsteck-Ausführung– .787“ [2,00mm]
2MR series stack-through receptacle
- ◆ **PC/104 Serie** Buchsenleisten, Durchsteck- und Einlötausführung– .100“ [2,54mm]
PC/104 series receptacle, stack-through and solder pin version

In dieser Ausgabe: See in this journal:

Steckverbinder mit Lot-Flussmitteldepots <i>Solder and flux bearing connectors</i>	1
Stift- und Buchsenleisten mit Lot-Flussmitteldepots <i>Solder and flux bearing headers and receptacles</i>	2
RoHS Konformität <i>RoHS Compliance</i>	
PC/104 und PC/104 Plus Steckverbinder <i>PC/104 and PC/104 Plus connectors</i>	3
Stiftleisten im Raster 2,54mm und 2 mm <i>Headers 2,54mm and 2 mm pitch</i>	3
PC Card und CompactFlash Stift- und Buchsenleisten <i>PC Card and Compactflash headers and receptacles</i>	3
Weitere Steckverbinder mit Lot-Flussmitteldepots <i>Further connectors with solder flux bearings</i>	3
Über uns <i>About us</i>	4

Kontaktieren Sie uns – wir sorgen für gute Kontakte!
Contact us – for your interconnection requirements!

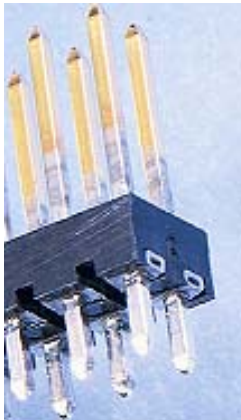
info@knap.at

www.knap.at

Stift- und Buchsenleisten mit Lot-Flussmitteldepots

Solder and flux bearing headers and receptacles

Bei der **Interplex Lot-Flussmitteldepot Technologie** sind an jedem Kontaktstift die richtige Menge an Lot- und Flussmittel in den Isolierkörper eingelegt.



Das Lot-Flussmitteldepot ist ausreichend um einen 100% Füllungsgrad in Schaltungen mit einer Stärke bis 2,54 mm nach IPC Klasse III zu gewährleisten. Verarbeitet werden die Stiftleisten mit herkömmlichen Lötverfahren. Zusätzliche Herstellschritte wie das Aufbringen von Flussmittel und zusätzlicher Lotpaste entfallen. Für eine animierte Funktionsdemonstration besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage

www.interplexnas.de/wDeutsch/Produkte/Steckverbindungen.php

Interplex TEKA Stift- und Buchsenleisten sind sowohl als Schüttgut als auch verpackt in Tape&Reel erhältlich.

The Interplex solder and flux bearing technology (SBL) provides every contact pin a precise and predetermined amount of solder alloy which is assembled into the insulating body.

An advantage of SBL technology is the ability to provide significant solder volume. It's possible to achieve 100% hole fill in

RoHS Konformität

RoHS Compliance

Interplex TEKA Stift- und Buchsenleisten werden nach der **RoHS-Richtlinie 2002/96/EC** gefertigt.

Die RoHS konformen **Interplex TEKA** Stift- und Buchsenleisten werden aus Phosphorbronze hergestellt, und sind mit einer matten Reinzinn- oder selektiver Goldoberfläche über Nickel beschichtet. Der Isolierkörper ist aus dem Hochtemperaturkunststoff LCP, UL94-V0, (Liquid Cristal Polymer) gefertigt.

Das eingebaute Lot-Flussmitteldepot enthält die Lotlegierung **Sn96,5Ag3,0 Cu0,5 inklusive no clean Flussmittel.**

Interplex TEKA's headers and receptacles are manufactured according to RoHS-directive 2002/96/EC.

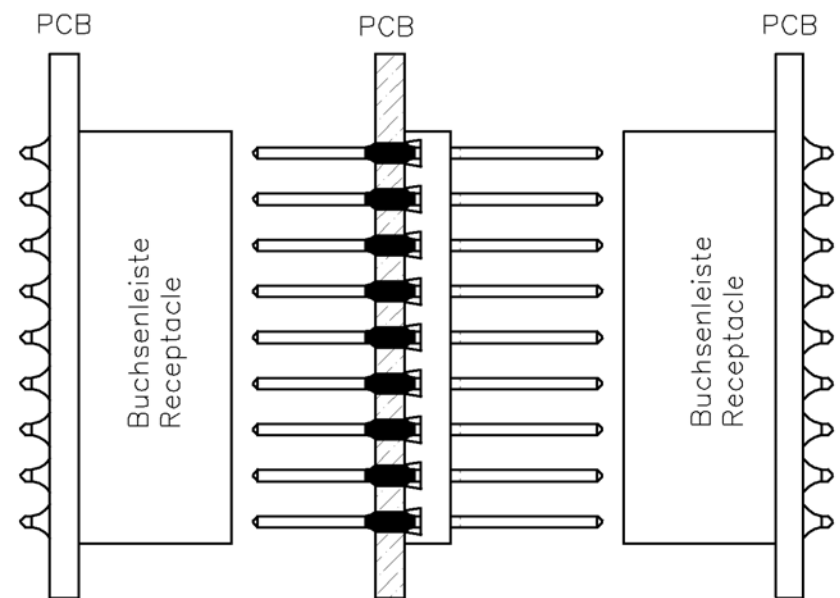


Der Umwelt zuliebe...
For a better environment...

PCB's to .100" thick. Satisfactory results (IPC Class III) can be achieved. Additional operations like fluxing and wetting with solderpaste are not necessary. To see a shockwaved animation please visit us on our homepage at

www.interplexnas.de/wEnglisch/Products/connectors.php

Interplex TEKA's headers and receptacles are available as bulk package or in tape and reel.



Steckverbindung zum „Stapeln“ mehrerer Schaltungen
Connector stackthrough application

Kontakte mit Lot-Flussmitteldepots
Verkürzen die Prozesszeit – ersparen
Nacharbeit!

Solder and flux bearing pins
Save time – save money – eliminate rejects!

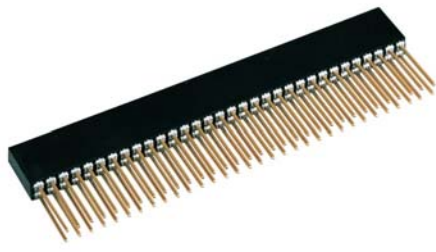
Kontaktieren Sie uns – wir sorgen für gute Kontakte!
Contact us – for your interconnection requirements!
info@knap.at www.knap.at

RoHS compliant Interplex TEKA's solder bearing (SBL) headers and receptacles are manufactured from base material phosphor bronze, the surface of the contact is coated with pure matte tin or selective gold, underplated with nickel. The insulating body is a high temperature plastic LCP (Liquid Cristal Polymer), UL 94-V0 rated.

The assembled leadfree solder-flux preforms contents the solder alloy Sn96,5Ag3,0 Cu0,5, flux type no clean

PC/104 und PC/104 Plus Steckverbinder PC/104 and PC/104 Plus connectors

PC/104 und PC/104 Plus Steckverbinder mit Lot-Flussmitteldepots vereinfachen den Fertigungsprozess und senken damit die Kosten.



Die innovative Technologie vereinfacht die Montage von Steckverbindern auf Schaltungen.

- ◆ Der Steckverbinder wird gemeinsam mit den anderen Komponenten in einem Reflowprozess gelötet
- ◆ Kein zusätzlicher Lötpasten-oder Flussmittelauftrag notwendig
- ◆ Erfüllt die PC/104 und PC/104Plus Spezifikationen

PC/104 and PC/104 Plus connectors with SBL wafer technology provide a wider reflow-processing window and makes the manufacturing process easier.

This innovative technology eliminates PC104 and Plus connector attachment problems

- ◆ Place connector on PCB and solder in-line to process in a convection oven
- ◆ No additional solder, solder paste or flux required
- ◆ Meets all applicable PC104 and PC104 Plus specifications



PC Card und CompactFlash Stift- und Buchsenleisten PC Card and Compactflash headers and receptacles

Die Interplex TEKA Stift- und Buchsenleisten erfüllen die Anforderungen der PCMCIA PC Card und CompactFlash Spezifikationen.

The Interplex TEKA headers and receptacles meets applicable PCMCIA PC Card and CompactFlash specifications.

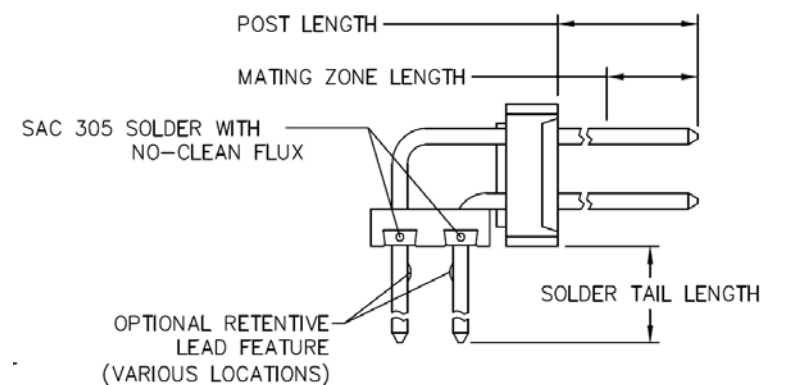
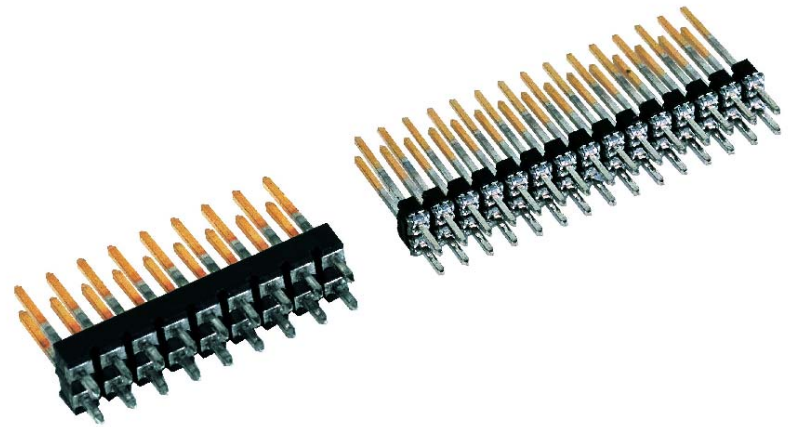


Stiflleisten im Raster 2,54mm und 2 mm Headers 2,54mm and 2 mm pitch



Verschiedene Oberflächenbeschichtungen, selektive Beschichtungen, einreihige und zweireihige Ausführungen, gerade und 90° gewinkelt.

Several surface coatings, selective coating, single- and dual rows, straight and right angle versions



Weitere Steckverbinder mit Lot-Flussmitteldepots Further connectors with solder flux bearings

Further connectors with solder flux bearings



SCA2 Fibre channel GBIC Plug



SCA2 receptacle SB Wafer



Quad row solder-flux bearing socket

50 Jahre Erfahrung
Experience since 50 years
www.interplex.com

Sie finden uns auch im Web!
Please visit us!
www.interplexnas.de

Die Firma **Interplex NAS Electronics GmbH** wurde im Jahr 1982 gegründet und ist ein Mitglied der weltweit tätigen **Interplex Industries Gruppe**. Unser Firmensitz ist in Heilbronn. Wir sind in Europa über unsere Vertretungen in Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz und Spanien präsent.

Wir beschäftigen uns mit der Lösung von Kontaktierungsproblemen bei dem Aufbau von elektronischen Schaltungen, Modulen, Hybriden, Multi-Chip Modulen und Baugruppen. Für die Anschluss- und Verbindungstechnik dieser Schaltungen bieten wir unsere patentierte Kontaktanschlusstechnik mit- und ohne Lot-Flussmittel Depot an.

Unsere weitere Kompetenz liegt im Bereich der Projektierung und der Fertigung von manuellen Vorrichtungen, Halbautomaten bis hin zu hochentwickelten automatischen Maschinen, inklusive selektiven Löt-systemen und Handhabungsrobotern zur kostenoptimierten Verarbeitung unserer Kontaktanschlusstechnik.

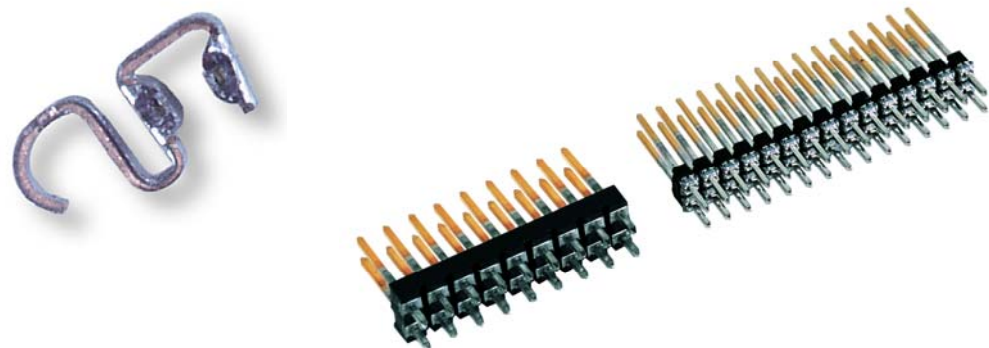
In unserem Dienstleistungsbereich bieten wir die Konfektionierung unserer Lötkontakte sowie die Verarbeitung von allen Varianten elektronischer Schaltungen unter Verwendung unserer patentierten Verbindungstechniken mit Lot-Flussmittel Depot an. Für die automatische Weiterverarbeitung verpacken wir die MCM Module, Hybride, PLCC und LCC Schaltungen optisch geprüft in Blistergurte versiegelt mit Abdeckband, und liefern diese auf Kunststoffspulen.

Interplex NAS Electronics GmbH was founded in 1982 as part of Interplex Industries Inc. We service the European market through representation in Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Italy, the Netherlands, Sweden, Switzerland, Spain and UK.

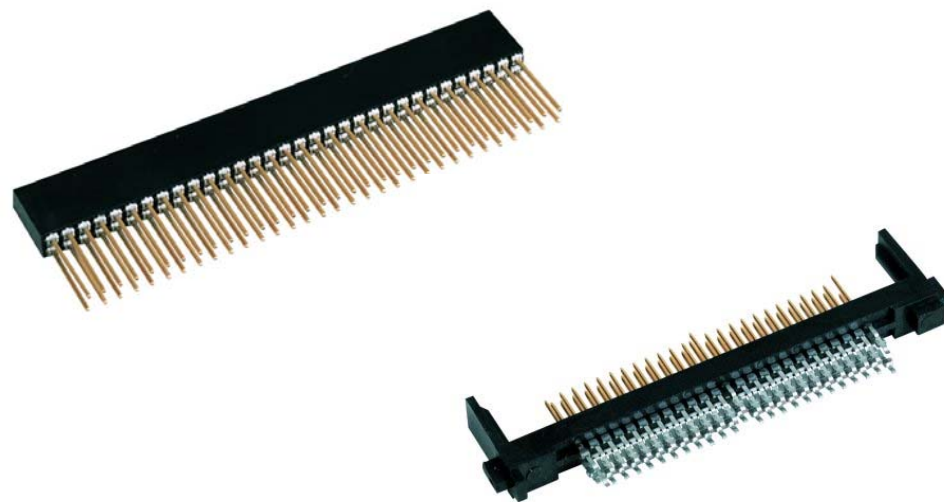
Interplex NAS Electronics offers turnkey solutions from product concept, design through production cycle for parts that incorporate electronic circuits, modules, hybrids and multi-chip modules. As a interconnection technology solution we offer our patented lead-frame technology of solder bearing leads.

We further enhance that solution by offering various stages of processing enhancements using our assembly and soldering equipment. Our equipment offerings comprise of manual tools, semi-automatic leadframe insertion and soldering systems to fully automatic machines with selective soldering and handling systems.

In order to minimize the investment costs and production time for our customers we also offer the following services at our location: Leadframe assembly and soldering on customers pre-populated pcb's/substrates. Tape and reel assembly and packing service to load the carrier tape pockets with finished multi-chip modules, hybrids, PLCC - and LCC circuits.



Kontakte mit Lot-Flussmitteldepots
Verkürzen die Prozesszeit – ersparen Nacharbeit!
Solder and flux bearing leadframes
Save time – save money – eliminate rejects!



**Zuständige
Vertretung:
Distributor:**

WK
Wolfgang Knap
Gesellschaft m.b.H. & Co. KG

A-1130 Wien
Lilienberggasse 13
Tel.: +43-1-403 08 12
Fax: +43-1-408 72 13
e-mail: info@knap.at
<http://www.knap.at>